

362kV GIS 외함 순환전류에 의한 접지본드 과열현상 및 대책

이제희*, 김승규*, 김순태*, 신명철**
 한국전력공사*, 성균관대학교**

**Investigation and Countermeasure of
 Sheath Circulating Current in the 362kV GIS**

J.H Lee*, S.K Kim*, S.T Kim*, M.C Shin**
 KEPCO*, S.K.K Univ**

Abstract - 본 논문에서는 362kV GIS 외함 유도 순환전류에 의한 접지본드 과열에 대하여 원인을 분석하고 대책을 마련하는 것을 목적으로 한다. 원인분석에는 접지본드 과열현상과 과열원인을 GIB 시스템 계산식을 이용하여 계산결과를 도출하였고 전자파도해석 프로그램 (EMTP : Electromagnetic Transient Program)에 의한 분석을 통하여 원인을 분석하고 대책을 마련하여 과열현상을 방지하고자 한다.

1. 서 론

한전에서는 우리나라 중서부 지역의 발전단지에서 생산하는 전력수송의 핵심역할을 수행할 765kV 계통을 2002년에 준공하여 운전하고 있다.

전압의 격상과 친환경 송변전설비 건설에 따라 GIS설비(Gas Insulated Switchgear)로 건설되어 운전하고 있는 변전소에서 부하의 증가 및 접지본드 용량부족으로 362kV GIS 외함 유도 순환전류에 의한 접지본드 과열현상이 발생되었다.

본 논문에서는 온도상승 요인을 규명키 위해 GIB 시스템 계산 및 전자파도해석 프로그램 (EMTP : Electromagnetic Transient Program)에 의한 분석으로 GIS 외함 유도순환전류에 의한 과열방지 방안을 마련코자 한다.

2. 본 론

2.1 과열 현상 및 원인

2.1.1. 접지본드 과열현상

과열발생설비는 765kV 신안성S/S 362kV GIS B상 GIB 플랜지부 (※ 기기제원 : 362kV / 4000A / 63kA)이고 발생부위는 362kV GIS #4M.Tr 2차 인출 D.S 상부 B상 GIB 플랜지부분 접지본드에서 상대적으로 높은온도가 발생되었다. 온도측정치는 표2-1과 같다.

표2-1. 플랜지 부위별 각 상 발열온도

플랜지 부위	상별 측정온도(℃)			비 고
	A상	B상	C상	
A 부분	35 ℃	39 ℃	35 ℃	
B 부분	85 ℃	187 ℃	88 ℃	
C 부분	70 ℃	113 ℃	70 ℃	
D 부분	70 ℃	103 ℃	71 ℃	
E 부분	85 ℃	94 ℃	80 ℃	
F 부분	86 ℃	87 ℃	140 ℃	
G 부분		93 ℃		
H 부분		120 ℃		
I ~ N 부분	50~73 ℃			

※ 측정 시부하
 ▶ 140만kW
 (2300A)
 ※ 측정 장치
 ↳ 써머비전

GIB 플랜지 부위별 온도측정결과에 의하면 온도가 M.Tr에서 개폐기부로 갈수록 상대적으로 높게 나타남을 알 수 있는데, GIB 플랜지부위별 구분은 그림2-1에 나타난바와 같고, 각 부위별 평균온도 상승치는 표2-2에 나타난바와 같다.

그림2-1. 플랜지 부위별 발열온도

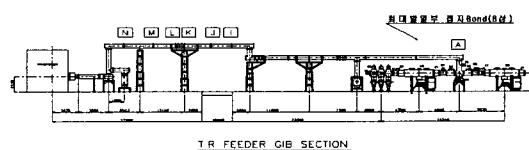


표2-2. GIS 플랜지별 상승온도

플랜지별	상승온도	비 고
B번 플랜지	약 200 ℃	△ 주위온도 : 26 ~ 28 ℃
C ~ H번 플랜지	약 120 ~ 140 ℃	△ 온도측정시 부하 : 1500~1600MW
I ~ M번 플랜지	약 100 ℃	△ 측정장치 : 써머비전(원거리 측정)

2.1.2 접지본드 과열원인

과열원인으로는 설계측면에선 접지본드 통전용량 부족을 들 수 있는데 362kV GIS 외함 유도 순환전류(약 3200A)에 대한 접지본드 설계시 1점 접지방식 (신안성S/S:다점 접지방식)의 접지본드 개수(2개) 적용으로, 접지본드 통전용량(600sq/허용전류: 1500A)이 통전전류 크기(약 3200A)보다 부족함으로써 접지본드에서 과열현상이 발생함을 알 수 있다(표2-3 참조).

362kV GIS 외함의 일반적인 유도 순환전류는 주 전류의 약 50 ~ 80 % 정도이며 신안성S/S 362kV GIS 외함 유도 순환전류 측정치는 주전류의 약 54 ~ 80%이다. GIB 시스템 계산치는 주 전류의 60% (계산명세 : 본문 2.2 참조)이며 신안성S/S 유도순환전류 크기는 주 전류가 4000A 인 경우 최대 약 3200A (=4000×0.8)임을 알 수 있다.

표2-3. GIS 접지방식 비교

1점 접지방식	다점 접지방식
▲ GIB 플랜지간 접지본드에 의한 연결 없이 GIB 각 구간별로 지지가대 접지 ▲ 유도 순환전류 흐르지 않음	▲ GIB 플랜지간을 접지본드로 연결하여 GIB 각 지지가대 접지 ▲ 접지본드를 통해 유도 순환전류 흐름

표2-4. 계산식

구 분	계 산 식						
입력 값	S: 상간거리(m), D _i : SHEATH 내경 (m) D _o : SHEATH 외경(m)						
	$C_0 = \frac{(D_i + (D_o - D_i)/2)}{2}$ $Ro = 5.71 * 10^{-7} * (1 + 0.0052 * (40 - 20))$ 여기서 $5.71 * 10^{-7}$: Sheath의 고유저항 (Ωm), 제질:STS 0.0052: 온도계수 ($1/\text{^\circ C}$), 40: 대표온도 (^\circ C)						
중간 계산식	$Rl = \frac{Ro * 4}{\pi * (D_o^2 - D_i^2)}$ $w = 2 * \pi * f$ 여기서 f: 주파수(HZ) $X = 2 * w * \log(\frac{S}{C_0}) * 10^{-7}$ $Aa = 2 * w * \log(2) * 10^{-7}$ $Bb = 2 * w * \log(5) * 10^{-7}$ $Y = X + Aa$ $Z = X - Aa/3$						
순환 계산식	i 는 1부터 100까지 $R(i) = Rl * i$ $M = R(i)/Y$ $N = R(i)/Z$						
상별 계산식	<table border="1"> <thead> <tr> <th>A 상</th> <th>B 상</th> <th>C 상</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$A = -(1 - \sqrt{3} * N)$ $B = M + \sqrt{3}$ $C = 2 * (M * N - 1)$ $D = 2 * (M + N)$ $Ka = K * 100\% = I_a/I * 100\%$</td> <td>$A = 0$ $B = -1$ $C = N$ $D = 1$ $Kb = K * 100\% = I_b/I * 100\%$</td> <td>$A = -(1 + \sqrt{3} * N)$ $B = M - \sqrt{3}$ $C = 2 * (M * N - 1)$ $D = 2 * (M + N)$ $Kc = K * 100\% = I_c/I * 100\%$</td> </tr> </tbody> </table> I: 주전류, I _a , I _b , I _c : SHEATH 전류	A 상	B 상	C 상	$A = -(1 - \sqrt{3} * N)$ $B = M + \sqrt{3}$ $C = 2 * (M * N - 1)$ $D = 2 * (M + N)$ $Ka = K * 100\% = I_a/I * 100\%$	$A = 0$ $B = -1$ $C = N$ $D = 1$ $Kb = K * 100\% = I_b/I * 100\%$	$A = -(1 + \sqrt{3} * N)$ $B = M - \sqrt{3}$ $C = 2 * (M * N - 1)$ $D = 2 * (M + N)$ $Kc = K * 100\% = I_c/I * 100\%$
A 상	B 상	C 상					
$A = -(1 - \sqrt{3} * N)$ $B = M + \sqrt{3}$ $C = 2 * (M * N - 1)$ $D = 2 * (M + N)$ $Ka = K * 100\% = I_a/I * 100\%$	$A = 0$ $B = -1$ $C = N$ $D = 1$ $Kb = K * 100\% = I_b/I * 100\%$	$A = -(1 + \sqrt{3} * N)$ $B = M - \sqrt{3}$ $C = 2 * (M * N - 1)$ $D = 2 * (M + N)$ $Kc = K * 100\% = I_c/I * 100\%$					
SHEATH FACTOR 계산식	$Xl = \frac{A * C + B * D}{C^2 + D^2}$ $Yl = \frac{B * C - A * D}{C^2 + D^2}$ $K = \sqrt{Xl^2 + Yl^2}$						

2.3 접지본드 과열현상별 원인분석

2.3.1 B상 GIB의 상대적 온도상승

접지본드 설계상 문제점(접지본드 통전용량 부족) 및 시공불량(접촉면 산화, 접지본드 체결 부적정 등)에 의한 접촉저항 증가로 국부적인 온도상승이 발생하여 볼트 통전 및 GIB 상간 임피던스 불균형이 발생함으로써, 국부과열이 발생한 B상 온도가 다른상 보다 높게 나타난 것으로 판단된다.

정상상태에서 상간 온도차와 접지본드 보강후 A, B, C상 상승온도를 비교한 결과 온도차가 미미함을 알수있었고 GIB 외합 임피던스 크기에 따라 자체 및 상간 전류크기 변하였다.

발열($=IR$)요인 추정으로 접지본드 전류(I) 증가는 A, C상에 비해 B상 GIB 외합의 재질 및 두께 등에 차가 있어 B상 저항이 상대적으로 낮은 경우 발생 가능하나 현 운전설비는 동일 재질, 동일 두께의 설비로 가능성이 없다.

접지본드 접촉저항(R) 증가는 접지본드와 플랜부와의 접촉불량시 발생 가능하며 GIB 조립시 시공결함이 있는 경우 접촉불량에 의한 접촉저항 증가 가능성이 있다.

시공결함 내용으로는 접촉면 산화(우천작업 등), 체결력 부족 또는 파다, 접지본드 자체결함으로 플랜지부와의 불완전 밀착, 체결전 액체 패킹 주입 등이 있고 추정근거는 B상 접지본드 일부에 액체패킹이 스며들어간(전체면의 30%) 흔적이 있었다.

A, C상 누설자속 영향에 의한 B상 외합 온도 상승은 GIB 상간거리가 2.5m 이고, 다중 접지된 점을 고려시 누설자속 영향에 의한 온도상승정도는 극히 미미(계산시 약 1°C)하다.

2.3.2 GIB 접지본드 및 접촉저항 변화시 3상 시스템 EMTP 해석결과

해석조건은 Shunt Bar가 Tr측 및 CB측에 모두 있는 것으로 가정하고, 주전류(I_1) = 1100A, 분기전류($I_2 = I_3$) = -550A, 플랜지당 접지본드 저항(접촉저항 포함)[$\mu\Omega$]은 표2-5와같이 조건을 상정했다.

표 2-5. 플랜지당 접지본드 저항

No.	A상	B상	C상
1	100	50	100
2	100	30	100
3	100	20	100

임피던스 크기차에 의한 전류차 변화 해설결과(3상 쉬스전류)는 각각 그림 2-3, 2-4, 2-5와 같다.

그림 2-3.B상 저항이 50 $\mu\Omega$ 인 경우(A, C상 100 $\mu\Omega$)

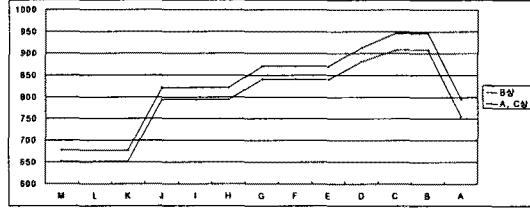


그림2-4. B상 저항이 30 $\mu\Omega$ 인 경우(A, C상 100 $\mu\Omega$)

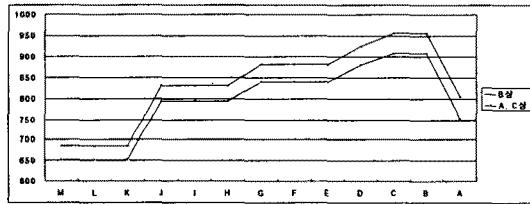
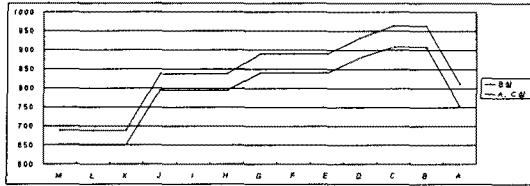


그림2-5. B상 저항이 20 $\mu\Omega$ 인 경우(A, C상 100 $\mu\Omega$)



3. 결 론

362kV GIS 접지본드 과열 방지책으로 접지본드의 개수를 현 2개에서 적격개수 4개(허용전류 : 3200A) 이상으로 설계하고 유효 접촉면적 확대를 위해 접지본드 체결용 와셔(일반와셔Φ18/30→Wood와셔Φ18/52)를 변경하여 접촉면 도장 제거면적을 충분히 함으로써 유효 순환전류에 의한 온도상승은 억제될것으로 사료된다.

[참 고 문 헌]

- [1] 일본중앙연구소, 일본전력 케이블 핸드북
- [2] EMTP Rule Book, ATP Salford Version, I, II, 1987
- [3] EMTP Case Study Workbook I ~ IV, Electrotek Concept, Inc, January 1997